

关键指标

频率: DC~30GHz
 衰减范围: 0.5~31.5dB
 衰减精度均方根: 0.6dB
 插入损耗: 5dB
 控制电平: 0/-5V
 芯片尺寸: 2mm×0.93mm×0.1mm

产品简介

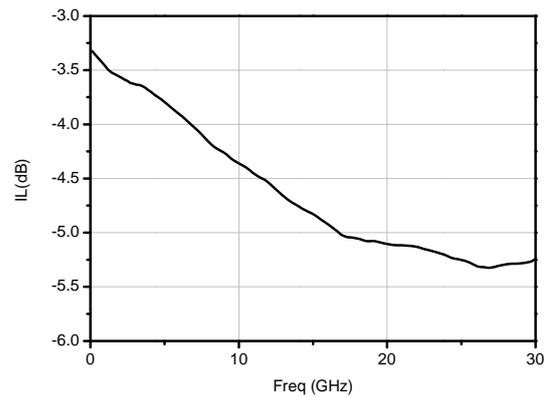
HG168S 是一款 DC~30GHz 六位数控衰减器芯片, 0/-5V 电平控制。

电性能 (T_A=25°C)

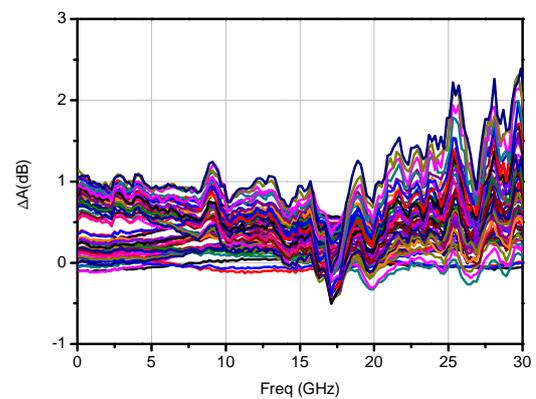
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~30		
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.4	-
插入损耗(dB)	-	5	-
衰减精度(dB)	-	-0.5~2.5	-
衰减精度均方根(dB)	-	0.6	-
相位波动(°)	-	-10~60	-

典型测试曲线

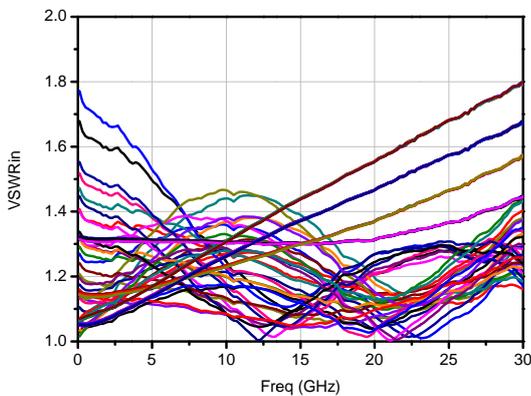
插入损耗



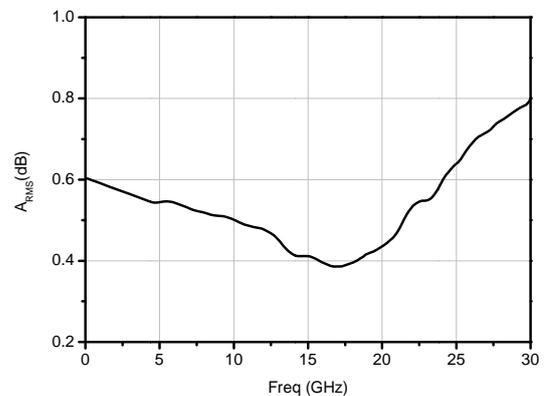
衰减精度



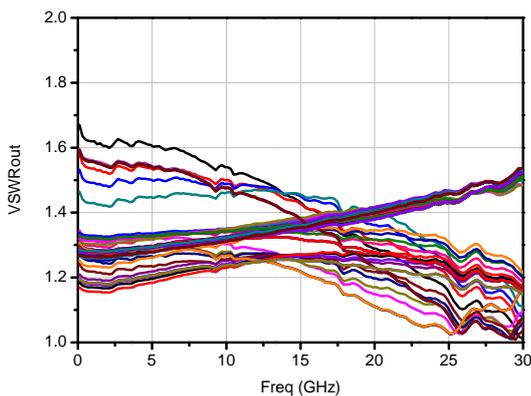
输入驻波



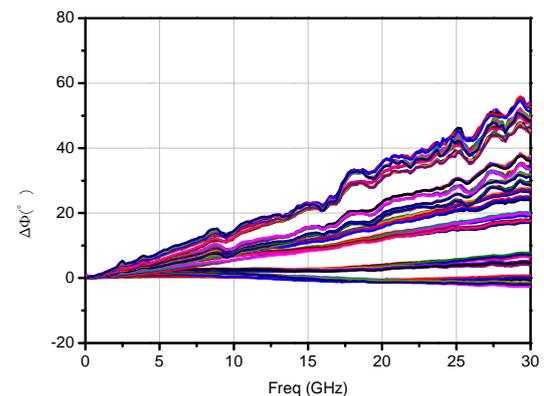
衰减精度均方根



输出驻波



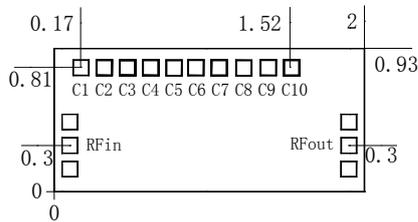
相位波动



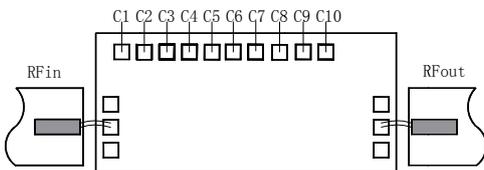
真值表 (0: 0V, 1: -5V)

状态	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
零态	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.5dB	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1dB	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
2dB	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1
4dB	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
8dB	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
16dB	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
31.5dB	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对最大额定值

最大输入功率	+27dBm
控制电压	-5.5V
工作温度	-55°C~125°C
贮存温度	-65°C~150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。